

可靠性

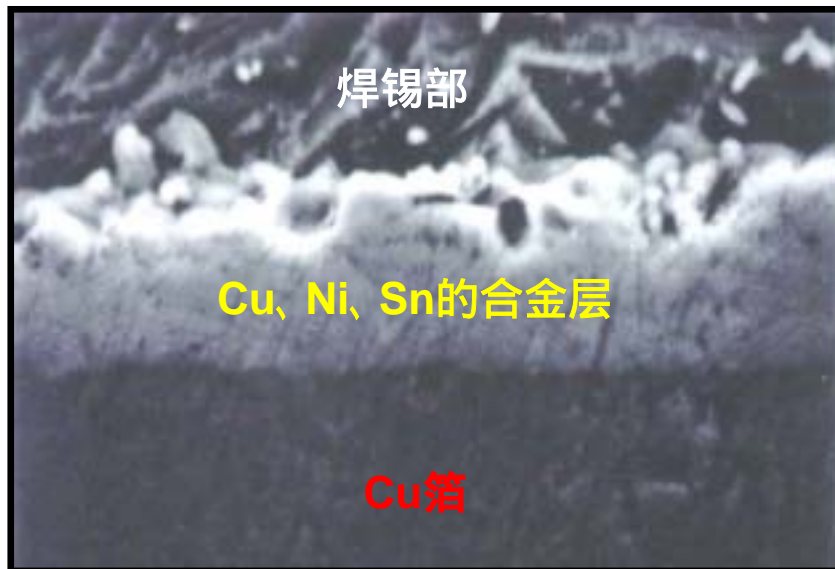
稳定的合金层



SN100C具有高可靠性的无铅焊锡。
以下对SN100C的「稳定的合金层」的形成进行说明。

稳定的合金层

SN100C在铜箔与焊锡的界面形成稳定的合金层。



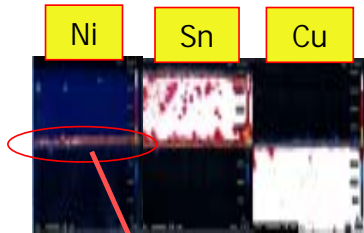
SN100C在铜箔与焊锡的界面形成Cu、Ni、Sn的稳定的合金层。

高温放置实验

[条件]

· 高温放置: 120

· 焊接温度: 255



Ni保护膜

$(\text{Cu}, \text{Ni})_6\text{Sn}_5$

Cu_6Sn_5

焊锡合金 时间 (h)	断面扩大照片		
	SN100C	Sn-0.7Cu	Sn-3.0Ag-0.5Cu
0			
192			
768			



在120 的条件下进行了高温放置试验。
Sn-0.7Cu、Sn-3.0Ag-0.5Cu随着时间其合金层也在成长、
而SN100C因有镍的保护效果、可以抑制合金层的成长。